SSM 4A / SSM 9

Reparatur von THT- Leiterplatten

The distribution of this document is not permitted without express permission – 05.25

SSM 4A / SSM9

**Die SSM 4A / SSM9 werden zum selektiven Ein- und Auslöten vielpoliger Bauelemente der Durchstecktechnik eingesetzt.
Wiederholbare Ergebnisse werden mittels definierten Prozessparameter erzielt.**

HAUPTMERKMALE

- Flexible Lösungen für **Standard- oder unregelmässig geformte Bauelemente**
- **Reproduzierbare Lötergebnisse** durch definierte Parameter wie Löttemperatur, Prozesszeit, Wellenhöhe, Ramp Up und Ramp Down oder bis zu 10 programmierbare Parameter bei der SSM 9
- **Einfache Höheneinstellung der Leiterplatte über der Lötwelle**
- Einfache Handhabung, stabiles Tischgerät
- **Auch unregelmässig geformte Leiterplatten mit einer Grösse von bis zu 840 mm x 600 mm** können aufgenommen und mit dem Schnellklemmen sicher fixiert werden
- **Ausblas-Option:** Zum Reinigen der Lötstellen nach dem Auslöten eines Steckers
- **Anwendungsspezifisches Zubehör:** Für jede Art von Bauelementen der Durchstecktechnik auch auf dicht bestückten Leiterplatten, Mehrfachlötungen, zum Benetzen von definierten Positionen
- **Optionales Vorwärmemodul PH 4,** speziell auch für die Anforderungen von Bleifrei-Anwendungen
- **Bleifrei-Nachrüstung:** Bereits installierte Maschinen können entsprechend für Bleifrei-Anwendungen nachgerüstet werden

PROGRAMMIERBARE PARAMETER

Durch definierte und definierbare Parameter wie Löttemperatur, Prozesszeit, Wellenhöhe, Ramp Up und Ramp Down entstehen präzise, reproduzierbare und personenunabhängige Lötergebnisse.

MARKTANFORDERUNGEN

Effizienzsteigerung

- Schnelle Positionierung mit Hilfe der Luftdüse
- Gleichzeitiges Aufschmelzen und Löten aller Anschlüsse
- Zuverlässiges Ausblasen der Löcher von oben, direkt nach Entfernen des Bauelementes

Qualitätssteigerung

- Präzise Einstellbarkeit der Lötparameter
- Reproduzierbare Resultate
- Schutz von Bauelement und Leiterplatte durch Wegfall mechanischer Beanspruchung
- Schutz von benachbarten Bauelementen bei Lötungen auf der Bauelementseite

ANWENDUNGSGEBIETE

Reparaturen
Austausch defekter Bauteile.

Prototypenbau
Prototypen können mit den Maschinen der SSM-Serie auf rationelle Art bestückt und gelötet werden.

Nachbestückung
- Zur Zeit der Produktion fehlen Bauelemente
- Auf der Lötseite sind Bauelemente zu bestücken
- Eine SMD-bestückte Leiterplatte muss mit einzelnen, bedrahteten Bauelementen ergänzt werden

Löten
Sind Leiterplatten mit nur wenigen Bauelementen zu bestücken, dann ist in vielen Fällen der Einsatz einer SSM Ein- und Auslötanlage der einfachste und preiswerteste Weg.

Rationelles Arbeiten
Das ergonomische Design erlaubt ein schnelles und einfaches Arbeiten mit Resultaten, die selbst höchsten Qualitätsanforderungen genügen.

Ausserordentlich breites Anwendungsspektrum
- Arbeiten an Multilayer-Leiterplatten
- Verarbeiten von Bauelementen mit komplizierten Geometrien, wie zB. Schalterblöcke und lange Steckerleisten
- Arbeiten an mischbestückten Leiterplatten
- Löten auf der Bestückungsseite, auch zwischen hohen benachbarten Bauelementen
- Ein- und Auslöten von Pin Grid Arrays und Sockel
- Löten auf Flex-Leiterplatte

OPTIONALES VORWÄRMERMODUL PH 4

Zur Leistungsoptimierung bei Bleifrei-Anwendungen

Das Vorwärmermodul PH 4 kann als Einzelgerät oder zusammen mit der SSM 4A oder SSM 9 eingesetzt werden. Durch das Vorwärmen der Leiterplatte bevor der selektive Lötprozess durchgeführt wird, wird das Risiko der Kupferablösung reduziert.
Das PH 4 Vorwärmermodul benutzt IR-Technologie zum Vorwärmen der Leiterplatten auf einer Fläche von 300 x 300 mm mit einer Leistung von 3500 Watt.

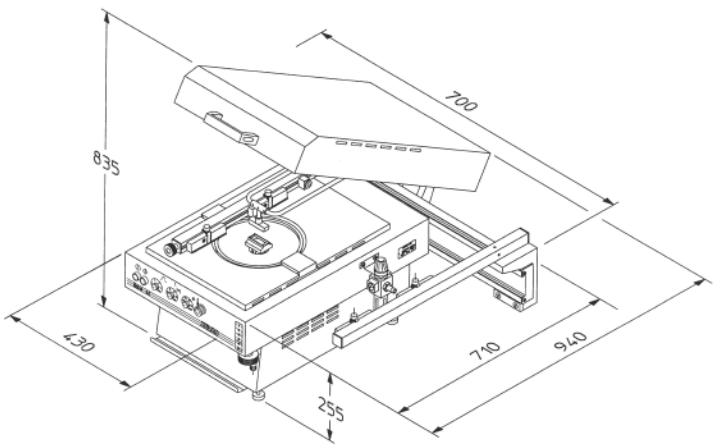
SSM 4A

Die SSM 4A wird zum selektiven Ein- und Auslöten vielpoliger Bauelemente der Durchstecktechnik eingesetzt. Wiederholbare Ergebnisse werden mittels definierten Prozessparametern erzielt.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	SSM 4A
Max. Leiterplatten-Abmessung	600 mm x 600 mm
Pumpsystem	Lotpumpe
Aufheizzeit	Ca. 30 min
Zyklusdauer	0 - 60 s
Druckluftanschluss	1 - 8 bar
Lottemperatur	200 °C - 300 °C
El. Anschlusswert	2500 Watt
Anschlussspannung	220 - 230 Volt, 50 Hz
Abmessung (L x B x H)	440 mm x 800 mm x 360 mm
Lotinhalt	Ca. 16 kg
Gewicht (ohne Lot)	47 kg

ABMESSUNGEN



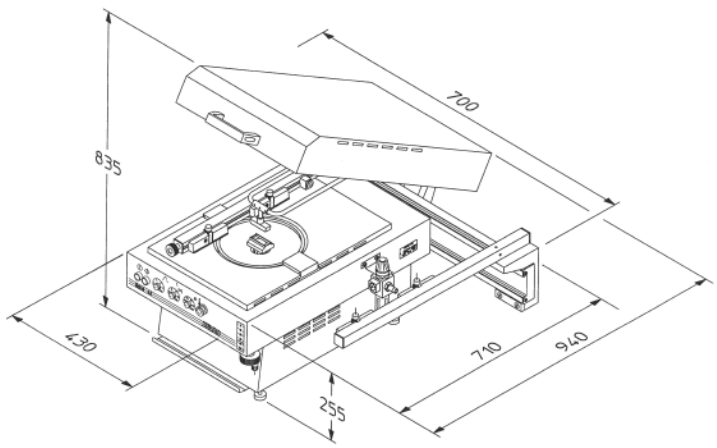
SSM 9

Die SSM 9 wird zum selektiven Ein- und Auslöten vielpoliger Bauelemente der Durchstecktechnik eingesetzt. Durch die programmierbaren Parameter werden wiederholgenaue und personenunabhängige Ergebnisse erzielt.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	SSM 9
Max. Leiterplatten-Abmessung	840 mm x 600 mm
Pumpsystem	Lotpumpe
Aufheizzeit	Ca. 30 min
Zyklusdauer	0 - 60 s
Druckluftanschluss	1 - 8 bar
Lottemperatur	235 °C - 400 °C
El. Anschlusswert	2500 Watt
Anschlussspannung	220 - 230 Volt, 50 Hz
Abmessung (L x B x H)	440 mm x 800 mm x 360 mm
Lotinhalt	Ca. 16 kg
Gewicht (ohne Lot)	75 kg

ABMESSUNGEN



ZEVAC
www.zevac.ch
info@zevac.ch
Tel. +41 32 626 20 80

Technologiestrasse 1
2540 Grenchen
Switzerland